

烟台德邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：德邦科技                      证券代码：688035                      编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	国海证券、大家资产、驼铃资产、泓德基金、太和致远基金、海通证券、开源证券、东方证券、中银证券、中电科投资、工银瑞信、长城财富、博道基金、华夏基金、银叶投资、长盛基金、华商基金等
时间	2025 年 2 月 12-20 日
地点	现场交流（烟台、上海、北京）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：于杰 公司证券总监：战世能
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2024 年经营情况？</p> <p>答：2024 年，公司集成电路、智能终端、新能源和高端装备四个板块业务都有积极的进展，各板块展现了增长韧劲，全年实现一定的增长。其中集成电路、智能终端板块增速明显，集成电路板块已形成了丰富多元的产品线，整体解决方案的能力不断增强，现有成熟产品均实现较好的增长，新产品方面几款芯片级封装材料，在客户端的导入上量进度也取得了不同程度的积极进展；智能终端板块随着终端客户新品发布带来增量，以</p>

	<p>及公司产品在新应用点的持续突破、导入，形成多点开花的局面；新能源板块主要产品市场份额保持基本稳定，部分新客户导入也取得实质进展，在部分产品单价下行的状态下仍实现销量和销售额同向增长；公司高端装备板块基数相对较小，也保持了大比例的增长。从收入结构来看，集成电路板块和智能终端板块营收占比均有所提升，新能源板块营收占比有所降低，公司营收结构收有所优化。</p> <p><b>2、公司昆山工厂和眉山工厂产线建设情况？</b></p> <p>答：昆山工厂 2024 全面投产，产能爬坡较快，除了新能源材料产线外，新建 UV 膜产线也开始投产，新增产能支撑了 2024 年 UV 膜增长需求，新建 DAF 产线也建成开始打样试生产。</p> <p>眉山工厂一期产能预计 2025 年二季度可以投产，覆盖西南地区宁德和比亚迪等客户需求，缓解了原来从烟台和昆山向眉山运输产品距离远的问题，成本和交付效率得到进一步优化，公司在新能源的产能布局体系基本搭建成型。</p> <p><b>3、公司半导体领域材料的进展？</b></p> <p>答：在先进封装材料领域，公司具备一系列成熟技术并能实现批量供货，其中芯片固晶胶，可以适用于多种封装形式，覆盖 MOS、QFN、QFP、BGA 和存储器等，</p>
--	--

	<p>客户包括通富微电、华天科技、长电科技等国内集成电路封测企业。晶圆 UV 膜方面，目前在华天科技、长电科技、日月新等国内集成电路封测企业批量供货。导热界面材料，TIM1.5、TIM2 广泛应用于手机、笔记本电脑、服务器、光通讯等领域，并已稳定批量出货。</p> <p>公司还有多款芯片级封装材料在客户端持续的推进导入上量，在验证周期方面，由于先进封装材料领域技术含量高、工艺难度大、属于知识密集型产业，产品验证存在周期长、难度大、结果较难预测的情况，目前DAF 膜已在部分客户实现量产出货，CDAF 膜、AD 胶、Underfill 材料实现部分客户小批量交付，TIM1 材料获得部分客户验证通过正在推进产品导入。</p> <p>另外，公司还围绕现有主业，通过收并购等资本运作方式加快发展步伐。2025 年 2 月 5 日公司发布了《烟台德邦科技股份有限公司关于收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-005），泰吉诺已成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。泰吉诺主要产品包括导热垫片、相变化材料、液态金属等高端导热界面材料，产品主要应用于 AI 服务器、GPU、CPU 主控芯片及智能消费电子领域，本次收购有助于扩充公司产品种类，完善产品方案，并拓展业务领域，加速公司在人工智能、先进封装领域的业务布局，促进公司半导体业务的快速、高质量发展，为公司开辟新的增长点。</p>
--	---

	<p data-bbox="643 219 1096 257"><b>4、公司智能终端板块营收情况？</b></p> <p data-bbox="576 295 1340 1003">答：从产品结构来看, 公司智能终端板块 TWS 耳机材料占比约 40%~50%，其他的包括整机里面的屏显、声学系统、光学系统、充电解决方案等材料占比约 50%~60%。公司智能终端板块 2024 年度实现快速增长，一方面是终端客户新品发布带来增量，另一方面是公司产品在新应用点的持续突破、导入带来份额提升。如苹果的新款 TWS 耳机、iPad、Vision Pro 等，安卓品牌如小米今年新推出小米 15 手机，公司为其“LIP0 立体屏幕封装技术”提供关键材料，另外公司切入的车载电子方面的应用带来了新增份额。</p> <p data-bbox="643 1115 1031 1153"><b>5、公司各板块毛利率变化？</b></p> <p data-bbox="576 1191 1340 1599">答：公司集成电路和智能终端板块的毛利率同比稳中有升，新能源整体上和去年没有太大变化，经过公司内部降本增效，如大宗采购议价、技术降本、自动化产线智能制造等各种措施的落地，新能源板块毛利率逐步恢复，整体上公司今年综合毛利率从年初的同比下降已恢复到与去年基本持平的水平。</p> <p data-bbox="643 1711 1128 1749"><b>6、公司的半导体材料有哪些优势？</b></p> <p data-bbox="576 1787 1340 1973">答：一方面是公司现在的产品体系、品类是国内半导体材料中相对较全的，产品从零级到三级封装材料全部覆盖，是国内比较稀缺的能够拿出全系列产品线的并</p>
--	---

	<p>且能够产业化的半导体材料企业。另一方面是公司的产品在客户端积累了丰富的验证数据和应用经验，得到了客户的检验和认可，产品质量具备了跟欧美日韩等头部半导体材料的企业竞争的能力。</p> <p><b>7、收购泰吉诺进展以及公司收购泰吉诺后热界面材料的整体业务结构？</b></p> <p>答：泰吉诺并表后，公司将拥有全资子公司深圳德邦界面和控股子公司泰吉诺两个以热界面材料为主营业务的经营主体，两个子公司在技术、客户、产能等方面协同效应明显，在终端应用领域方面存在一定的错位、互补。泰吉诺产品主要集中在 AI 领域，网络通讯、汽车电子、消费电子等领域也有批量出货；深圳德邦界面则是在汽车电子、网络通讯、消费电子领域具备明显优势，AI 领域也有涉足。泰吉诺并表后，公司热界面材料业务更为全面的覆盖多个应用领域，完善了产品序列，能够满足客户更多的产品解决方案需求。后续两个业务主体将从研发、产品、市场等方面深度融合，持续巩固和强化在各业务领域的优势地位。</p> <p><b>8、公司热界面材料在新能源汽车上的应用？</b></p> <p>新能源汽车涵盖多个芯片、模组或控制单元，对热界面材料的需求量很大，根据发热程度不同对热界面材料均会有不同程度的需求。目前公司热界面材料已批量</p>
--	--

	应用于充电系统、电控系统、功率转换与控制系统、域控制系统、激光雷达、动力电池系统等，并在持续关注和开发新的应用点。
附件清单（如有）	无